



CASA

第三代半导体产业技术创新战略联盟
China advanced semiconductor industry
innovation alliance

第三代半导体产业技术创新战略联盟

关于团体标准 T/CASAS 060—2025《用于 HEMT 功率器件的硅衬底氮化镓外延片》发布的通知

各成员单位：

按照 CASAS 相关管理办法，团体标准 T/CASAS 060—2025《用于 HEMT 功率器件的硅衬底氮化镓外延片》已遵照流程完成制定工作，现予以发布。

T/CASAS 060—2025《用于 HEMT 功率器件的硅衬底氮化镓外延片》

本文件主要起草单位：苏州晶湛半导体有限公司、北京中博芯半导体科技有限公司、厦门市三安集成电路有限公司、中山大学、中国科学院半导体研究所、工业和信息化部电子第五研究所、北京大学东莞光电研究院、广东工业大学、大连理工大学、珠海镓未来科技有限公司、中国科学院微电子研究所，芯联集成电路制造股份有限公司、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

本文件主要起草人：向鹏、程凯、卢国军、叶念慈、刘成、刘扬、贾利芳、施宜军、刘强、贺致远、黄火林、王中党、曾凡明、康玄武、王钰、王文平、高伟。

特此通知。

北京第三代半导体产业技术创新战略联盟

2025 年 8 月 29 日

